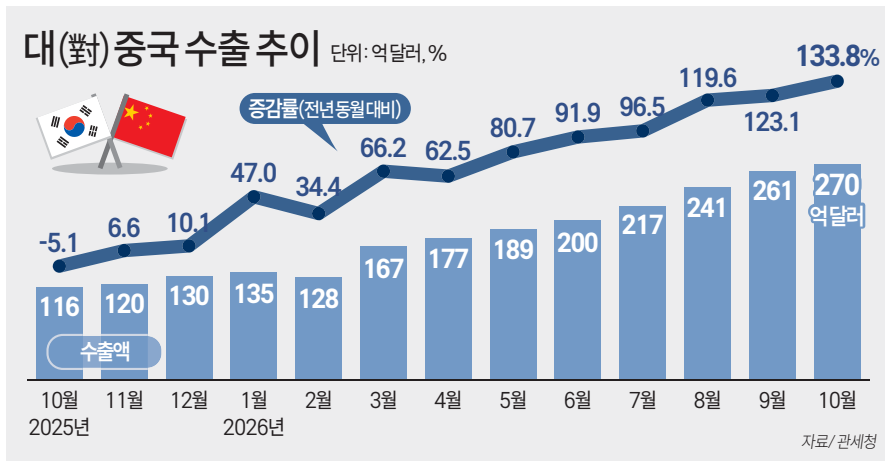
韓, 10월 對中 수출 270억달러… 반도체 중심 2배 이상 증가

고성능 메모리 중심 수요 확대
中 첨단산업-부동산 투자 격차
상품 소비회복은 여전히 더뎌



반도체가 한국의 대(對)중 수출을 두 배 넘게 끌어 올렸지만 중국의 상품 소비 회복은 여전히 더디다. 고성능 메모리 수요와 가격 강세가 수출액을 밀어올리는 동안 중국 내부에서는 첨단산업 투자와 가계 소비·부동산 경기 사이의 간극이 이어지고 있다.

17일 관세청이 발표한 10월 수출입 확정치에 따르면 지난달 대중 수출은 270억 1100만달러로 전년 동월보다 133.8% 증가했다. 한국의 10월 수출에는 조업일수가 지난해 20일에서 올해 22일로 늘어난 영향도 반영됐다.

같은 달 중국의 소매판매 증가율은 0.4%로 9월의 1.1%보다 낮아졌다. 상품 판매와 외식 매출을 합친 지표로, 한국의 대중 수출 급증과는 다른 흐름을 보였다.

◆ 수출액 키운 반도체

대중 수출 호조의 중심에는 반도체가 있다. 산업통상부와 과학기술정보통신부가 지난 15일 발표한 정보통신산업(ICT) 수출입 잠정 집계에서 10월 중국 본토행 ICT 수출은 211억5000만달러였다. 이 가운데 반도체는 188억6000만달러로 89.2%를 차지했다. 수출액은 전년 동월보다 326.5% 늘었다.

정부는 AI 산업 성장에 따른 고성능 메모리 수요와 D램 중심의 초과수요, 메모리 가격 강세를 반도체 수출 증가의 배경으로 설명했다. 같은 자료에 제시된 8Gb D램 단가는 10월 27.5달러로 전년 동월보다 292.9% 올랐다. 반도체 수출액이 기업의 수요와 가격 변화에 함께 영향을 받는다는 의미다.

중간재 교역의 특성도 고려해야 한다. 반도체 등 중간재는 중국 기업의 생산에 투입돼 현지에서 소비되거나, 추가 가공을 거쳐 제3국으로 수출될 수 있다. 수출 목적지가 중국이라고 해서 그 수요가 모두 중국 가계의 상품 구매에서 나오는 것은 아니다.

품목별 수출과 현지 판매의 움직임도 달랐다. 한국의 대중 디스플레이 수출은 18.3%, 휴대폰 수출은 부분품을 포함해 3.9% 감소했다. 반면 중국 내 일정 규모 이상 유통업체의 통신기기 소매판매는 6.5% 늘었다. 통계의 품목 범위는 다르지만, 한국산 수출의 등락을 중국 소비 변화만으로 설명하기 어렵다는 점을 보여준다.

◆ 반도체·정보서비스 투자와 부동산의 간극

중국 안에서도 투자 분야별 차이가 나타났다. 국가통계국에 따르면 1~10월 고정자산투자는 전년 같은 기간보다 8.1% 감소했지만 집적회로 제조업 투자는 13.8% 증가했다. AI 등 신산업과 밀접한 정보서비스업 투자도 20.5% 늘었다.

반면 같은 기간 부동산 개발투자는 21.6% 감소했다. 첨단산업과 부동산으로 향하는 투자 흐름이 갈린 것.

푸링후이 국가통계국 대변인은 16일 브리핑에서 경제의 안정적 흐름을 강조하면서도 국내의 "공급 강세·수요 약세가 여전히 뚜렷하다"고 진단했다.

◆ 서비스 소비는 상대적 선방

소비 내부에서는 서비스가 상대적으로 선방했다. 1~10월 서비스 소매판매는 전년 같은 기간보다 4.9% 늘어 상품 소매판매 증가율인 0.9%를 웃돌았다. 10월 자동차를 제외한 소매판매도 2.5% 증가했다.

국가통계국은 중추절 시점 이동과 일부 내구재 판매 증가세 둔화를 10월 상품 판매 증가율이 낮아진 배경으로 꼽았다. 낮은 소매판매 증가율만으로 중국 소비 전체가 정체됐다고 판단하기 어려운 이유다.

다만 소비 회복의 제약은 남아 있다. 린송 ING 중화권 수석이코노미스트는 "소비자 신뢰가 계속 약한 것이 소비 회복을 가로막는 핵심 문제"라고 지적했다.

반도체가 이끄는 수출 호조를 중국 내수 전반의 회복으로 확대 해석하기는 어렵다. 한국 기업의 대중 사업 여건도 반도체 수요·가격과 현지 가계의 소비 여건에 따라 다르게 움직일 수 있다.

푸 대변인은 "소비 확대를 위해 고용 안정과 소득 증대가 필요하다"고 강조하면서 "주민의 소비 능력과 의향은 더 강화될 필요가 있다"고 말했다. /김주형 기자

gh471@metroseoul.co.kr

삼성·SK, 내년 성장 전망 불확실성 커져

D램 가격 상승세 둔화 등 제약 예상
차세대 제품 양산·수익성 확보 과제

삼성전자와 SK하이닉스가 역대급 실적에 힘입어 현금성 자산 329조원을 쌓았지만 내년 성장 전망에는 불확실성이 커졌다. 글로벌 인공지능(AI) 투자 전망이 하향 조정되면서 고대역폭메모리(HBM) 증산을 통한 매출 확대와 수익성 확보가 관건으로 떠올랐다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 3분기 말 기준 회사의 '현금·현금성 자산 및 단기금융 상품' 규모는 총 329조2339억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기보다 약 193조원 증가한 수준이다. 그러나 현금성 자산 증가에도 내년에는 D램 가격 상승세 둔화로 실적 성장에 제약이 예상된다. 전일 하나증권은 D램 평균판매가격 상승률이 삼성전자는 올해 282%에서 내년 15%로, SK하이닉스는 191%에서 33%로 낮아질 것으로 전망했다.

여기에 글로벌 AI 반도체 투자 전망까지 하향 조정되면서 향후 메모리 수요에 대한 불확실성도 커졌다. 미국 반도체 전문 분석기관 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 지난 13일 2027년 글로벌 AI 가속기 투자 전망치를 기존 7700억달러(약 1031조원)에서 6270억달러(약 839조원)로 19% 낮췄다. 2029년 전망치도 41% 하향했다.

AI 가속기 투자 전망이 낮아지면서 HBM 출하량 전망도 조정됐다. 2028년 글로벌 출하량 예상치는 9.0엑사바이트(EB)에서 6.4EB로 30% 축소됐다. AI 기업들의 매출 증가세 둔화와 데이터센터 자금 조달 부담이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 공급 부족 완화에 따른 HBM 가격 하락 가능성도 제기됐다.

다만 중장기 전망 하향에도 내년 AI 가속기 투자액은 올해보다 약 60% 증가할 것으로 예상된다. 삼성전자와 SK하이닉스도 이러한 수요 확대에 대응해 생산시설 확충을 추진하고 있다.

삼성전자는 내년 HBM 공급 물량의 판매를 완료하고 차세대 HBM4E 양산을 추진 중이다. 충남 아산 온양사업장에는 총 46조원을 단계적으로 투자해 HBM 패키징 생산능력을 확대할 계획이다. 이 가운데 6조원을 투입하는 신규 생산시설은 2028년 6월 가동을 목표로 건설 중이다.

SK하이닉스도 청주 M15X의 생산능력을 확대하고 용인 반도체 클러스터 가동을 준비하고 있다. 회사는 주요 고객사 14곳과 장기공급계약을 체결해 2027년부터 2년간 전체 생산능력의 절반 이상에 해당하는 공급 물량을 확보했다.

생산능력 확대와 함께 공급계약의 가격 조건도 향후 수익성을 좌우할 변수다. 삼성전자는 내년 HBM 공급 물량에 대해 목표 수준의 가격으로 협상을 마쳤으며 SK하이닉스는 고객사와 합의한 가격 범위에서 시장 상황을 반영하는 계약 구조를 운영하고 있다.

다만 내년 공급 물량 확보에도 2028년 이후에는 AI 투자 둔화와 HBM 가격 하락 가능성이 부담으로 작용할 전망이다. 신규 증산 물량의 판매 규모와 가격이 중장기 수익성을 좌우할 것으로 예상된다.

반도체 업계 관계자는 "내년까지는 HBM 수요가 견조하겠지만 2028년 이후에는 AI 투자 규모와 공급 여건에 따라 시장 상황이 달라질 수 있다"며 "신규 생산시설 가동에 따른 공급 확대 속도와 수익성을 함께 고려해야 할 것"이라고 말했다.

/구남영 기자 koogija_tea@

엔비디아, 공급망 운영 전략 공개

제품출하 단축… 안정적 생산·납품 부각

엔비디아가 젠슨 황 전 최고경영자(CEO) 퇴진으로 경영 불확실성이 커진 가운데 글로벌 협력사와 구축한 인공지능(AI) 인프라 공급 역량을 강조했다. 경영진 교체 속에서도 안정적인 생산과 납품을 뒷받침할 기반을 부각한 것으로 풀이된다.

17일 엔비디아 데브 쇼퀴스트 운영 부문 수석부사장은 공식 블로그를 통해 공급망 운영 전략을 공개했다. 쇼퀴스트 수석 부사장은 "공급망 추적 체계를 통해 수급 상황에 따라 TSMC의 칩 출하부터 폭스콘·위스트론의 완제품 출하까지 걸리는 시간을 5주에서 2주로 줄였다"고 밝혔다.

핵심은 공장별 생산 실적에 따른 물량 배정이다. 쇼퀴스트 부사장은 "매주 각 공장의 생산 성과를 확인하고 수율이나 운영 효율이 기대에 미치지 못하면 추가 칩을 배정하지 않는다"고 설명했다. 이어 "개별 반도체 칩의 식별번호부터 고객 송장까지 모든 칩을 추적하며 공급업체에도 이 체계를 지원하도록 요구한다"고 말했다.

이번 공급망 전략 공개는 콜렛 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡은 직후 이뤄졌다. 기존 제조 네트워크가 당장의 납품을 뒷받침한다면, 협력사 투자와 장기 구매 약정은 차세대 제품의 생산 능력을 확보하는 기반이다. 새 경영진의 투자 기조가 향후 공급망 확장 속도를 좌우할 전망이다.

/구남영 기자 koogija_tea@

K-기업, 'CES 2027' 전략 윤곽
휴머노이드 로봇 중심 기술 대전

삼성전자, 스마트폰 제조 노하우 집약
LG전자, 안전성·상호작용 차별화
현대차그룹, '실용주의 물리력' 강조


미국 조지아주 현대차그룹 로보틱스 메타플랜트 응용센터(RMAC)에서 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 훈련하는 모습. /보스턴다이나믹스

매년 IT·전자·자동차 시장의 트랜드를 엿볼 수 있는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2027'이 두 달여 앞으로 다가오면서 국내 주요 기업들의 전략이 모습을 드러내고 있다. 국내 대표 산업군을 이끄는 삼성전자와 LG전자, 현대차그룹이 휴머노미드 로봇 기술 경쟁은 단순 외형 모방을 넘어 각 사의 주력 사업 역량을 이식한 '시그니처 기술' 대결로 확전되고 있다.

17일 업계에 따르면 이들 3사는 휴머노이드 로봇 상용화의 성패가 범용 스펙이 아닌 '현장 맞춤형 독점 기술'에 달렸다고 보고, 각각 ▲초인적 기동성(현대차) ▲초정밀 조작(삼성) ▲공간 안전·교감(LG)을 전면에 내세워 차별화 전략을 구사하고 있다.

삼성전자는 반도체와 스마트폰 정밀 제조에서 축적한 노하우를 바탕으로 '사람 같은 손'과 '실전 데이터'에 초점을 맞추고 있다. 삼성의 휴머노이드는 현대차와 달리 사람과 동일한 다섯 손가락(5지)을 구현했다. 인간의 힘줄처럼 케이블을 당겨 구동하는 텐던(Tendon) 방식과 직구동 기술을 결합해 얇은 카드를 집거나 정밀 전자부품을 조립할 수준의 섬세한 조작력을 확보했다. 여기에 전 세계 100여 개 자체 생산라인을 실증 테스트베드로 활용해 현장 데이터를 학습시키고, 독자 온디바이스 AI 반도체와 주변 환경을 예측하는 '월드 모델'을 결합해 기술 장벽을 높이고 있다. 삼성전자는 이번 CES에서 자체 개발한 휴머노이드 로봇을 처음 공개할 방안을 모색중인 것으로 알려졌다.

LG전자는 산업 현장을 넘어 가정과 상업 공간에서 인간과 공존하는 '안전성과 상호작용(HRI)'을 핵심 무기로 내세웠다. LG전자는 휴머노이드 '클로이드' 등을 앞세워 사람과 작업하는 환경에서의 충돌 방지 및 안전 인증 표준 개발을 주도하며 LG 데이터팩토리를 통한 생활·공정 데이터 축적에도 속도를 내고 있다. 아울러 LG디스플레이·LG이노텍 등 부품 계열사와의 시너지를 통해 로봇 얼굴에 자연스러운 표정과 시선 추적을 구현하는 전용 디스플레이 등 인간 친화적 인터페이스를 차별화 포인트로 삼았다.

현대차그룹은 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스를 통해 인간 신체 구조의 한계를 뛰어넘는 '실용주의 물리력'을 시그니처로 삼았다. 보스턴다이나믹스의 대표 모델인 전동식 '아틀라스'는 목·허리·팔다리 등 56개 자유도(DoF) 관절이 360도 회전하도록 설계됐다. 몸을 돌릴 필요 없이 관절만 회전해 뒤쪽 부품을 집어 올릴 수 있어 완성차 조립 라인의 동선과 작업 시간을 획기적으로 단축한다. 손 역시 내구성과 전력 효율을 극대화한 '4지(4손가락)' 구조를 채택했으며, 최대 50kg의 고하중 부품을 들고 균형을 잡는 전신 제어 기술로 중후장대 제조 현장에 최적화했다. 특히 보스턴다이나믹스는 지난 9일 아틀라스에 발 대신 휠을 장착하고 다양한 고난도 동작을 수행하는 모습을 공개하며 기술 고도화에 속도를 높이고 있음을 알렸다. /양성운 기자 ysw@